【新卒可・半導体技術企画】先行技術動向分析・経営層向け技術レポート作成担当

グローバル環境/残業ほぼなし/即入社OK/在留資格サポートあり

募集職種

採用企業名
株式会社iSoftStone Japan

求人ID
1621281

業種
電気・電子・半導体

会社の種類
大手企業 (300名を超える従業員数) - 外資系企業

外国人の割合
外国人 少数

雇用形態
正社員

勤務地
神奈川県

給与
500万円 ~ 800万円

ボーナス
固定給+ボーナス

勤務時間
基本勤務：9:00 ~ 18:00 制度：フレックスタイム制あり

休日・休暇
土日完全週休二日制、有給休暇、その他日本法定祝日あり

更新日
2026年11月03日 17:59

応募必要条件

職務経験
1年以上

キャリアレベル
新卒・未経験者レベル

英語レベル
基礎会話レベル

日本語レベル
ビジネス会話レベル

最終学歴
大学卒： 学士号

現在のビザ
日本での就労許可は必要ありません

募集要項

・半導体分野における先行技術・新技術動向の調査・分析（論文・特許・学会・業界トレンド等）

・半導体分野における先行技術・新技術動向の調査・分析（論文・特許・学会・業界トレンド等）
・技術的観点から中長期ロードマップの策定、技術テーマ検討の支援
・経営層・技術責任者向け技術分析レポートや提案資料の作成
・社内 R&D 部門・事業部門と連携し、技術課題・開発方向性の整理
・学会・外部パートナーとの技術交流、社内への知見展開。必要に応じ、シミュレーション・技術フィージビリティ検討といった初期検証業務を支援

**職場雰囲気
外資系企業。約 8 割が現地採用の日本人社員。自由度が高く裁量権のある社風。

【必須（MUST）】
・半導体または関連分野での研究開発経験（デバイス / プロセス / 回路 / 材料 / パッケージング等）
・論文・特許などの技術文献を読み解き、自ら技術的考察・判断を実施した経験
・技術テーマを構造的に整理し、意思決定を支援する資料作成・プレゼンテーション経験
・日本語での業務遂行能力、英語技術文献の読解力

【あると望ましい（WANT）】
・下記いずれかの分野に専門性または強い関心をお持ちの方
  -先端パッケージング（2.5D/3D、異種集積、熱対策など）
  -先端材料（低誘電率材料、高熱伝導材料など）
  -プロセッサ / メモリアーキテクチャ（CPU/GPU/NPU 等）
  -AI/ML 関連ハードウェア、画像処理・演算技術
・技術企画、先行研究、技術戦略、産学連携の実務経験
・学会参加、社外技術コミュニティでの活動経験

会社説明